

DOTITEシリーズ

導電性接着剤シリーズ



ドータイト (DOTITE) 導電性接着剤カタログ

藤倉化成株式会社

<2023/9/12版>



ドータイト 導電性接着剤選定早見表①

タイプ	品名	硬化温度 (°C)																保管条件		塗布方法
		23	50	60	70	80	100	120	130	150	160	180	190	200	210	220	290	常温	冷凍	
標準タイプ	XA-874									30 MIN		10 MIN							3か月	DS /SP
低温硬化タイプ	XA-910						60 MIN	30 MIN		15 MIN									2か月	DS /SP
	AA2121-M シリーズ					60 MIN													3か月	DS /MP
	AA2001 シリーズ	24 Hrs	2 Hrs		30 MIN														3か月 暫定	DS
高耐熱タイプ	AA1221-A												30 MIN						2か月 暫定	DS
	AA1221-R									30 MIN									2か月 暫定	DS
	AA1301-B1											10 MIN					20 MIN		2か月	DS
柔軟タイプ	AA1101-V									30 MIN				15 MIN					4か月	MP
	AA1101-S											60 MIN							6か月	DS
	FA-750									60 MIN									4か月	DS
	AA07									60 MIN									2か月	DS

1) DS: デイス Pens、SP: スクリーン印刷、MP: メタルマスク印刷、ST: 転写 2) 緑数字: 仮乾燥時間

ドータイト 導電性接着剤選定早見表②

タイプ	品名	硬化温度 (°C)														保管条件		塗布方法
		60	70	80	100	120	130	150	160	175	180	200	210	220	250	冷蔵	冷凍	
高接着タイプ	XA-5905							30 MIN			10 MIN						3か月	DS / ST
	AA1221-P									60 MIN							6か月	DS / ST
狭ピッチ電極対応タイプ	AA2901-A						1-3 MIN		※1 30 SEC								4か月	SP
錫電極対応タイプ	XA-5617										60 MIN	10 MIN					2か月	MP
	XA-5651A										60 MIN	10 MIN					2か月	DS
短時間硬化タイプ	AA2201-A												1 MIN				6か月	DS
	AA2141-E						4 MIN										3か月	DS
シタリングタイプ (加圧)	AA1901-EP1			3-5 MIN			※2 10 SEC								※3 5 MIN		2か月 暫定	DS / MP
シタリングタイプ (無加圧)	AA1901-EN1											60 MIN					2か月 暫定	DS / SP
	AA1901-JE1											120 MIN					2か月 暫定	DS / MP

※1 圧力2～5MPa熱圧着による本硬化 ※2 圧力3MPa熱圧着による仮固定 ※3 圧力10MPa熱圧着による本硬化

1) DS: ディスペンス、SP: スクリーン印刷、MP: メタルマスク印刷、ST: 転写 2) 緑数字: 仮乾燥時間

ドータイト 導電性接着剤選定早見表③

タイプ	品名	硬化温度 (°C)																保管条件		塗布方法	
		23	50	60	70	80	100	120	130	150	160	175	180	200	210	220	290	冷蔵	冷凍		
低銀含有タイプ	AA14								60 MIN	30 MIN		15 MIN	15 MIN							3か月	DS / SP
絶縁タイプ	AZ2121-N1					60 MIN														2か月 暫定	DS
	AZ1221-T2											60 MIN								6か月	DS
	AZ2152-H3					60 MIN														2か月	DS / SP

1) DS: ディスペンス、SP: スクリーン印刷、MP: メタルマスク印刷、ST: 転写

ドータイト 導電性接着剤ラインナップ

標準タイプ

特長	品名	樹脂 フィラー	塗布 ^{*1} 方法	使用 条件	保管 条件	導電性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	接着強度 ^{*2} (N/mm^2)	Tg ($^{\circ}\text{C}$)
熱分解 320 $^{\circ}\text{C}$ 車載実績あり	XA-874	無溶剤 1液エポキシ Ag	DS /SP	150 $^{\circ}\text{C}$ 30min 適用電極: 金/銀/銅	冷凍 3か月	8×10^{-5}	20	78

低温硬化タイプ

特長	品名	樹脂 フィラー	塗布 ^{*1} 方法	使用 条件	保管 条件	導電性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	接着強度 ^{*2} (N/mm^2)	Tg ($^{\circ}\text{C}$)
100 $^{\circ}\text{C}$ 硬化 FPC部品実装	XA-910	無溶剤 1液エポキシ Ag	DS /SP	100 $^{\circ}\text{C}$ 60min 適用電極: 金/銀/銅	冷凍 2か月	2×10^{-4}	16	60
80 $^{\circ}\text{C}$ 硬化 低熱応力	AA2121-M シリーズ ※別タイプ有	無溶剤 1液エポキシ Ag	DS /MP	80 $^{\circ}\text{C}$ 60min 適用電極: 金/銀/銅	冷凍 3か月	$5 \sim 10$ $\times 10^{-4}$	8~13	90
23 $^{\circ}\text{C}$ 硬化 PC・ABS対応	AA2001 シリーズ ※別タイプ有	無溶剤 2液エポキシ Ag	DS	23 $^{\circ}\text{C}$ 24hrs 適用電極: 金/銀/銅/ガラス セラミック/シリコン	常温 3か月	$2 \sim 9$ $\times 10^{-4}$	5~10	31

* 1) DS: ディスペンス、SP: スクリーン印刷、MP: メタルマスク印刷、ST: 転写 * 2) ダイシエア強度

ドータイト 導電性接着剤ラインナップ

高耐熱タイプ

特長	品名	樹脂 フィラー	塗布 方法	使用 条件	保管 条件	導電性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	接着強度 (N/mm^2)	Tg ($^{\circ}\text{C}$)
熱分解 360 $^{\circ}\text{C}$ セラミック基板 対応 ダイアタッチ用	AA1221-A	無溶剤 1液エポキシ Ag	DS	190 $^{\circ}\text{C}$ 30min 適用電極: 金/銀/銅	冷凍 2か月 (暫定)	4×10^{-4}	25	100
熱分解 360 $^{\circ}\text{C}$ セラミック基板 低温硬化 ダイアタッチ用	AA1221-R	無溶剤 1液エポキシ Ag	DS	150 $^{\circ}\text{C}$ 30min 適用電極: 金/銀/銅	冷凍 2か月 (暫定)	2×10^{-4}	20	140
熱分解 400 $^{\circ}\text{C}$ <N ₂ 中> ポリイミド樹脂 高耐熱タイプ セラミック基板 対応	AA1301-B1	1液ポリイミド Ag	DS	180 $^{\circ}\text{C}$ 10min + 290 $^{\circ}\text{C}$ 20min 適用電極: 金/銀	冷凍 2か月 (暫定)	2×10^{-4}	10 ^{*3}	290

* 1) DS: デイス Pens、SP: スクリーン印刷、MP: メタルマスク印刷、ST: 転写 * 2) ダイシエ強度 * 3) 垂直引張強度

ドータイト 導電性接着剤ラインナップ[°]

柔軟タイプ[°]

特長	品名	樹脂 フィラー	塗布 ^{*1} 方法	使用 条件	保管 条件	導電性 (Ωcm)	接着強度 ^{*2} (N/mm^2)	Tg ($^{\circ}\text{C}$)
シリコンシート 上の部品実装 弾性率 25MPa	AA1101-V	無溶剤 1液シリコン	MP	160 $^{\circ}\text{C}$ 30min 適用電極: 金/銀	冷凍 4か月	5×10^{-4}	1.0 ^{*3}	-120
シリコン 柔軟タイプ [°] 水晶デバイス 弾性率 130MPa	AA1101-S	1液シリコン	DS	180 $^{\circ}\text{C}$ 60min 適用電極: 金/銀	冷凍 6か月	2×10^{-4}	2.0 ^{*3}	-120
エポキシ/ウレ タン柔軟タイプ [°] 水晶デバイス 弾性率 600MPa	FA-750	1液エポキシ /ウレタン	DS	150 $^{\circ}\text{C}$ 60min 適用電極: 金/銀/銅	冷蔵 4か月	3×10^{-4}	3	6
柔軟エポキシ タイプ [°] SAWフィルター 車載実績あり 弾性率 900MPa	AA07	無溶剤 1液エポキシ	DS	150 $^{\circ}\text{C}$ 60min 適用電極: 金/銀/銅	冷凍 2か月	2×10^{-4}	12	25

* 1) DS: ディスペンス、SP: スクリーン印刷、MP: メタルマスク印刷、ST: 転写 * 2) ダイシエ強度 * 3) 垂直引張強度

ドータイト 導電性接着剤ラインナップ

高接着タイプ

特長	品名	樹脂 フィラー	塗布 ^{*1} 方法	使用 条件	保管 条件	導電性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	接着強度 ^{*2} (N/mm^2)	Tg ($^{\circ}\text{C}$)
23 $^{\circ}\text{C}$ 接着強度 45 N/mm^2 電子部品の金属 キャップ ^o 接合	XA-5905	無溶剤 1液エポキシ Ag	DS /ST	150 $^{\circ}\text{C}$ 30min 適用電極: 金/銀/銅	冷凍 3か月	4×10^{-4}	45	75
260 $^{\circ}\text{C}$ 接着強度 6 N/mm^2 LED素子用 ステンレス対応	AA1221-P	無溶剤 1液エポキシ Ag	DS /ST	175 $^{\circ}\text{C}$ 60min 適用電極: 金/銀/銅/ ステンレス	冷凍 6か月	2×10^{-4}	25	100

狭ピッチ電極対応タイプ

特長	品名	樹脂 フィラー	塗布 ^{*1} 方法	硬化 条件	保管 条件	導電性 (Ω)	ピール強度 (N/cm)	L/S ^{*3} (mm)
エポキシ系異方 導電性ペースト コネクター接合	AA2901-A	1液エポキシ Agめつき樹 脂ビーズ (20 μm)	SP	仮乾燥: IR炉 130 $^{\circ}\text{C}$ 60~180sec 本硬化: 圧力2~ 5MPa 160 $^{\circ}\text{C}$ 20~30sec	冷凍 4か月	1.6 (ITOガラス 10 Ω /□)	3.5	0.3/0.3

* 1) DS: デispens SP: スクリーン印刷 MP: メタルマスク印刷 ST: 転写 * 2) ダイシエ強度 * 3) L/S=Line/Space

ドータイト 導電性接着剤ラインナップ

錫めっき対応タイプ

特長	品名	樹脂 フィラー	塗布 方法 ^{*1}	使用 条件	保管 条件	導電性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	接着強度 ^{*2} (N/mm^2)	Tg ($^{\circ}\text{C}$)
 <p>抵抗値安定 -65$^{\circ}\text{C}$⇔125$^{\circ}\text{C}$ ヒートサイクル</p>	XA-5617	無溶剤 1液エポキシ Ag	MP	200 $^{\circ}\text{C}$ 10min 180 $^{\circ}\text{C}$ 60min 適用電極: 金/銀/銅	冷凍 2か月	3×10^{-4}	17	90
	XA-5651A	1液エポキシ Ag	DS					

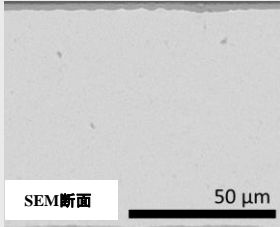
短時間硬化タイプ

特長	品名	樹脂 フィラー	塗布 方法	使用 条件	保管 条件	導電性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	接着強度 (N/mm^2)	Tg ($^{\circ}\text{C}$)
210 $^{\circ}\text{C}$ 1min 硬化 エポキシ系	AA2201-A	無溶剤1液 エポキシAg	DS	ホットプレート 210 $^{\circ}\text{C}$ 1min 適用電極:金/銀/銅	冷凍 6か月	2×10^{-4}	8	120
130 $^{\circ}\text{C}$ 4min 硬化 弾性率 27MPa	AA2141-E	無溶剤2液 ウレタンAg	DS	130 $^{\circ}\text{C}$ 4min 適用電極:金/銀/銅	冷蔵 3か月	8×10^{-4}	1.5	-12

* 1) DS: ディスペンス、SP: スクリーン印刷、MP: メタルマスク印刷、ST: 転写 * 2) ダイシエア強度

ドータイト 導電性接着剤ラインナップ°

シンタリングタイプ° (加圧、無加圧)

特長	品名	樹脂 フィラー	塗布 ¹ 方法	使用 条件	保管 条件	導電性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	接着強度 ² (N/mm^2)	Tg ($^{\circ}\text{C}$)
加圧タイプ° 	AA1901-EP1	樹脂なし Ag	DS /MP	80°C 3-5min + 3MPa 130°C 10sec + 10MPa 250°C 5min 適用電極: 金/銀	冷凍 2か月 (暫定)	4×10^{-6}	80	—
無加圧タイプ° 	AA1901-EN1	樹脂なし Ag	DS /SP	200°C 60min 適用電極: 金/銀	冷凍 2か月 (暫定)	4×10^{-6}	10	—
無加圧タイプ° 	AA1901-JE1	樹脂あり Ag	DS /MP	200°C 120min 適用電極: 金/銀/銅/ガラス セラミック/シリコン	冷凍 2か月 (暫定)	4×10^{-6}	30	—

* 1) DS: デイス Pens、SP: スクリーン印刷、MP: メタルマスク印刷、ST: 転写 2) ダイシエア強度

ドータイト 導電性接着剤ラインナップ[°]

低銀含有タイプ[°]

特長	品名	樹脂 フィラー	塗布 ^{*1} 方法	使用 条件	保管 条件	導電性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	接着強度 ^{*2} (N/mm^2)	Tg ($^{\circ}\text{C}$)
銀含有率 30wt%	AA14	無溶剤 1液エポキシ Ag/Ni	DS /SP	150 $^{\circ}\text{C}$ 30min 適用電極: 金/銀/銅	冷凍 3か月	3×10^{-4}	10	59

絶縁タイプ[°]

特長	品名	樹脂 フィラー	塗布 ^{*1} 方法	使用 条件	保管 条件	導電性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	接着強度 ^{*2} (N/mm^2)	Tg ($^{\circ}\text{C}$)
80 $^{\circ}\text{C}$ 硬化 低温接合	AZ2121-N1	無溶剤 1液エポキシ アルミナ	DS	80 $^{\circ}\text{C}$ 60min 適用基材: 金属/セラミック	冷凍 3か月	-	10	TBD
Tg120 $^{\circ}\text{C}$ 高接着 高耐熱	AZ1221-T2	無溶剤 1液エポキシ シリカ	DS	175 $^{\circ}\text{C}$ 60min 適用基材: 金属/セラミック	冷凍 6か月	-	40	120
80 $^{\circ}\text{C}$ 硬化 低温接合 チオール硬化	AZ2152-H3	無溶剤 1液エポキシ アルミナ	DS /SP	80 $^{\circ}\text{C}$ 60min 適用基材: 金属/セラミック	冷凍 2か月	-	12	25

*1) DS: ディスペンス、SP: スクリーン印刷、MP: メタルマスク印刷、ST: 転写 *2) ダイシエア強度

ドータイト 導電性接着剤特性表①

タイプ	品名	塗布方法	硬化条件	保管温度	可使用時間 (H)	導電性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	粘度 (dPa·s)	接着強度 (N/mm ²)	熱伝導率 (W/m·K)	不揮発分 (%)	TGA 1%減温度(°C)
標準タイプ	XA-874	DS/SP	150°C30min	冷凍	48	8×10^{-5}	300	20	3.6	97	348
低温硬化タイプ	XA-910	DS/SP	100°C60min	冷凍	24	2×10^{-4}	400	16	2.1	98	339
	AA2121-M シリーズ	DS/MP	80°C60min	冷凍	24	$5 \sim 10 \times 10^{-4}$	300 ~ 700	8 ~ 13	3.9	98	307
	AA2001 シリーズ	DS	23°C24hrs 50°C2hrs	常温	1	$2 \sim 9 \times 10^{-4}$	700 ~ 800	5 ~ 10	3.0 ~ 5.0	100	301
高耐熱タイプ	AA1221-A	DS	190°C30min	冷凍	24	4×10^{-4}	90	25	2.5	95	356
	AA1221-R	DS	150°C30min	冷凍	24	2×10^{-4}	90	20	TBD	95	360
	AA1301-B1	DS	180°C10min + 290°C20min	冷凍	24	2×10^{-4}	650	10	—	70	442
柔軟タイプ	AA1101-V	MP	160°C30min	冷凍	30	5×10^{-4}	650	1.0	2.0	97	331
	AA1101-S	DS	180°C60min	冷凍	120	2×10^{-4}	300	2.0	—	93	>500
	FA-750	DS	150°C60min	冷凍	336	3×10^{-4}	55	3.0	—	87	342
	AA07	DS	150°C60min	冷凍	30	2×10^{-4}	265	12	1.7	94	300

ドータイト 導電性接着剤特性表②

タイプ	品名	塗布方法	硬化条件	保管温度	可使用時間 (H)	導電性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	粘度 ($\text{dPa} \cdot \text{s}$)	接着強度 (N/mm^2)	熱伝導率 ($\text{W}/\text{m} \cdot \text{K}$)	不揮発分 (%)	TGA 1%減温度($^{\circ}\text{C}$)
高接着タイプ	XA-5905	DS/ST	150 $^{\circ}\text{C}$ 30min	冷凍	24	4×10^{-4}	265	45	3.3	97	359
	AA1221-P	DS	175 $^{\circ}\text{C}$ 60min	冷凍	24	2×10^{-4}	250	25	2.0	TBD	TBD
狭ピッチ電極対応タイプ	AA2901-A	SP	130 $^{\circ}\text{C}$ 60~180sec 2~5MPa 160 $^{\circ}\text{C}$ 20sec	冷凍	120	1.6 Ω (ITO ガラス 10 Ω /□)	360	3.5 N/cm	—	50	—
錫電極対応タイプ	XA-5617	MP	200 $^{\circ}\text{C}$ 10min	冷凍	8	3×10^{-4}	5000	17	2.2	99	342
	XA-5651A	DS	180 $^{\circ}\text{C}$ 60min	冷凍	8	3×10^{-4}	250	17	2.2	94	340
短時間硬化タイプ	AA2201-A	DS	ホットプレート 210 $^{\circ}\text{C}$ 1min	冷凍	30日	2×10^{-4}	160	8	1.2	97	334
	AA2141-E	DS	130 $^{\circ}\text{C}$ 4min	冷蔵	2	8×10^{-4}	260	1.5	—	100	278
シンタリングタイプ 加圧型	AA1901-EP1	DS/MP	80 $^{\circ}\text{C}$ 3-5min 3MPa 130 $^{\circ}\text{C}$ 10sec 10MPa 250 $^{\circ}\text{C}$ 5min	冷凍	24 (暫定)	4×10^{-6}	520	80	>200	93	TBD
シンタリングタイプ 無加圧型	AA1901-EN1	DS/SP	200 $^{\circ}\text{C}$ 60min	冷凍	24 (暫定)	4×10^{-6}	170	10	200	93	TBD
	AA1901-JE1	DS/MP	200 $^{\circ}\text{C}$ 120min	冷凍	24 (暫定)	4×10^{-6}	600	30	170	95	TBD

ドータイト 導電性接着剤特性表③

タイプ	品名	塗布方法	硬化条件	保管温度	可使用時間 (H)	導電性 ($\Omega \cdot \text{cm}$)	粘度 ($\text{dPa} \cdot \text{s}$)	接着強度 (N/mm^2)	熱伝導率 ($\text{W}/\text{m} \cdot \text{K}$)	不揮発分 (%)	TGA 1%減温度($^{\circ}\text{C}$)
低銀含有タイプ	AA14	DS/SP	150 $^{\circ}\text{C}$ 30min	冷凍	48	3×10^{-4}	170	10	—	94	318
絶縁タイプ	AZ2121-N1	DS	80 $^{\circ}\text{C}$ 60min	冷凍	8 (暫定)	—	35	10	—	TBD	TBD
	AZ1221-T2	DS	175 $^{\circ}\text{C}$ 60min	冷凍	24	—	70	40	—	TBD	TBD
	AZ2152-H3	DS/SP	80 $^{\circ}\text{C}$ 60min	冷凍	24	—	70	12	—	TBD	TBD

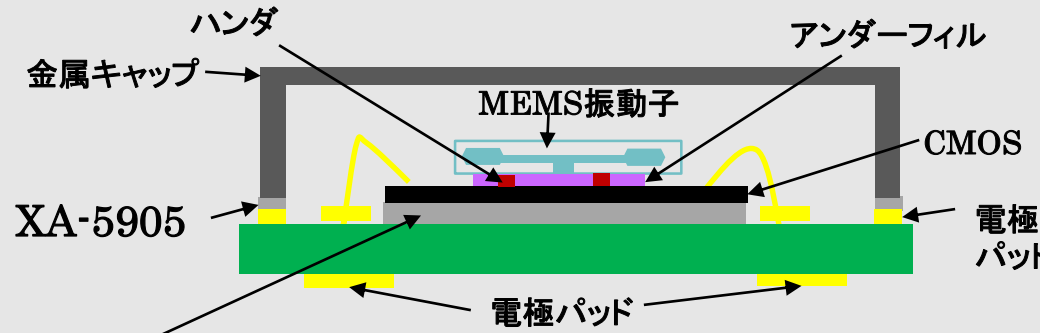
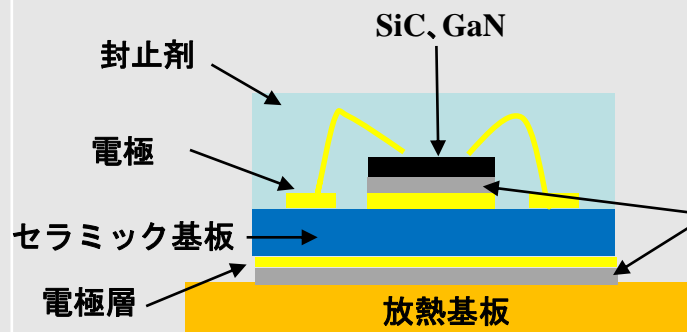
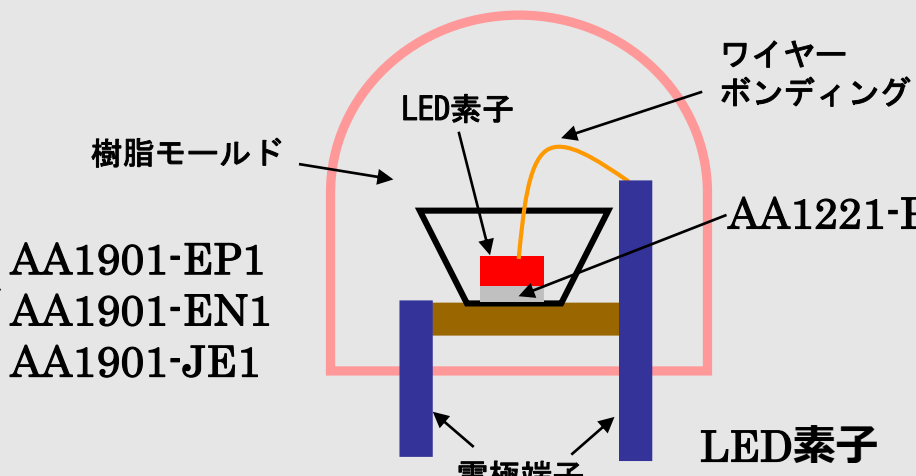
ドータイト 導電性接着剤用途例

低温硬化タイプ

品名	用途
XA-910 AA2121-Mシリーズ AA2001シリーズ	<ul style="list-style-type: none"> •タッチパネルトランスファ―電極接合 •フレキシブル基板部品実装 •カメラモジュール基板接合 •デフロスター電極接合 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="430 464 963 664"> <p>導電性ペースト回路</p> <p>端子電極 デフロスター電極端子接合</p> </div> <div data-bbox="1067 421 2020 635"> <p>XA-910</p> <p>導電性ペースト回路</p> <p>TPトランスファ―電極接合</p> </div> <div data-bbox="430 792 1170 1320"> <p>導電性ペースト回路</p> <p>AA2121-Mシリーズ AA2001シリーズ</p> <p>筐体 バネ レンズ 磁石 コイル IRカットフィルタ モジュール基板 基板</p> <p>カメラモジュール基板接合</p> </div> </div>

ドータイト 導電性接着剤用途例

高耐熱タイプ・高接着タイプ・シンタリングタイプ(加圧、無加圧)

品名	用途
AA1221-A	<ul style="list-style-type: none"> ・パワー半導体 ・ダイアタッチ (光半導体) ・MEMS ・金属キャップ接合 
AA1221-R	
AA1301-B1	
XA-5905	
AA1221-P	
AA1901-EP1	<p>AA1221-A、AA1221-R、AA1301-B1 MEMS振動子</p>
AA1901-EN1	
AA1901-JE1	
	

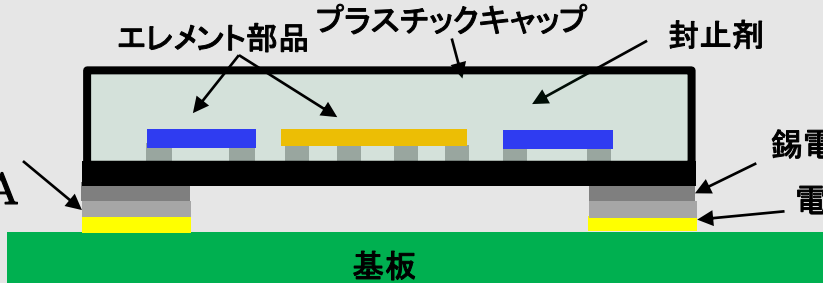
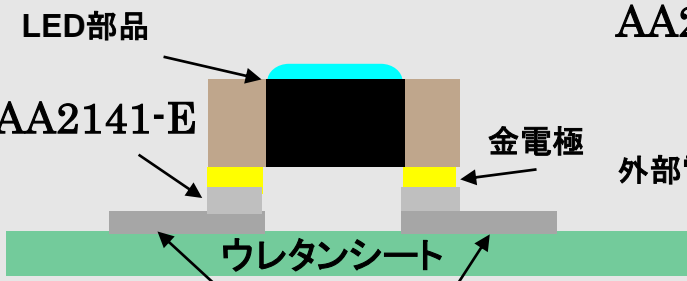
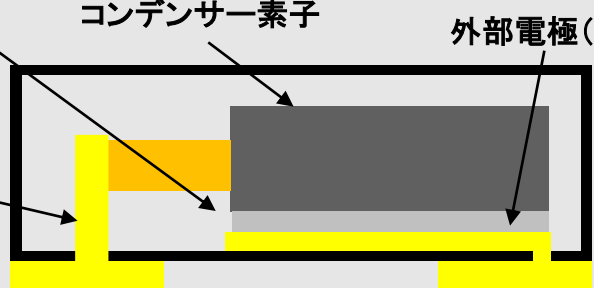
ドータイト 導電性接着剤用途例

柔軟タイプ^o

品名	用途
AA1101-V	<ul style="list-style-type: none"> フレキシブル回路用部品実装 セラミック振動子 水晶振動子 センサー部品 SAWフィルター
AA1101-S	
FA-750	
AA07	

ドータイト 導電性接着剤用途例

錫めっき対応タイプ・短時間硬化タイプ

品名	用途
XA-5617 XA-5651A AA2201-A AA2141-E	<ul style="list-style-type: none"> ・錫めっき部品実装 ・コンデンサー陰極接合 ・フレキシブル回路実装  <p>この図は、モジュール部品実装の断面図を示しています。基板（緑色）の上に電極パッド（黄色）があり、その上に錫電極（黒色）が形成されています。さらにその上に封止剤（透明）が塗布され、その中にLED部品（青い）とプラスチックキャップ（黒い）が配置されています。また、封止剤の側面には封止剤（透明）が塗布されています。</p> <p>XA-5617 XA-5651A</p> <p>エレメント部品 プラスチックキャップ 封止剤 錫電極 電極パッド 基板</p> <p>モジュール部品実装</p>
	 <p>この図は、フレキシブル回路実装の断面図を示しています。基板（緑色）の上に導電性ペースト回路（灰色）があり、その上にウレタンシート（透明）が貼られています。さらにその上にLED部品（黒い）が配置され、その両側に金電極（黄色）が形成されています。</p> <p>LED部品 AA2141-E 金電極 ウレタンシート 導電性ペースト回路</p> <p>フレキシブル回路実装</p>  <p>この図は、コンデンサー素子の陰極接合の断面図を示しています。外部電極（陽極）（黄色）と外部電極（陰極）（黒い）があり、その間にコンデンサー素子（灰色）が配置されています。また、外部電極（陽極）の側面には外部電極（陽極）（黄色）が形成されています。</p> <p>AA2201-A コンデンサー素子 外部電極（陰極） 外部電極（陽極）</p> <p>コンデンサー素子の陰極接合</p>

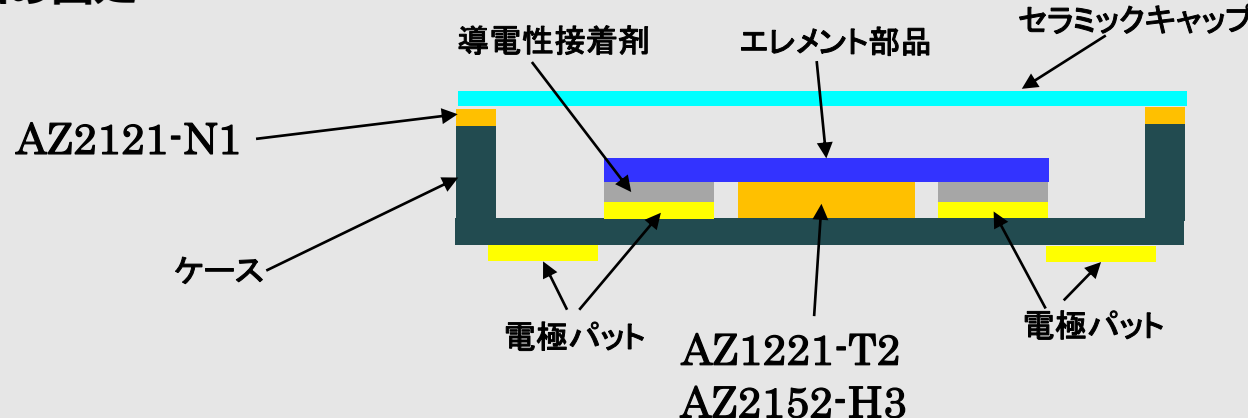
ドータイト 導電性接着剤用途例

狭ピッチ電極対応タイプ

品名	用途
<p>AA2901-A</p> <ul style="list-style-type: none"> セラミックパッケージ部品実装 コネクター接合 FPDのドライバーIC接続 RFIDのICチップ <p>【AA2901-A接合部断面】</p> <div data-bbox="414 778 1129 1206"> <p>◆ ACPテストベース(L/S=0.5mm/0.5mm)/ENIG フィルム 作製条件: IR130°C120sec+3MPa 160°C20sec 断面観察(SEM)</p> </div>	<p>導電粒子</p> <p>基板もしくはFPC</p> <p>電極</p> <p>絶縁</p> <p>導通</p> <p>コネクター接合 (AA2901-A)</p> <p>セラミックパッケージ部品</p> <p>電極パッド</p> <p>基板</p> <p>距離短い</p>

ドータイト 導電性接着剤用途例

絶縁タイプ

品名	用途
AZ2121-N1 AZ1221-T2 AZ2152-H3	<ul style="list-style-type: none"> セラミックパッケージ部品のキャップ接合 エレメント部品の固定  <p style="text-align: center;">セラミックパッケージ部品</p>

海外インベントリー登録状況①

■ REACH（欧州）につきましては別途ご相談下さい

タイプ	品名	TSCA (米国)	IECSC (中国)	TCSI (台湾)
標準タイプ	XA-874	×	○	○
低温硬化タイプ	XA-910	×	○	○
	AA2121-Mシリーズ	調査中	○	○
	AA2001シリーズ	○	○	○
高耐熱タイプ	AA1221-A	調査中	○	○
	AA1221-R	○	○	○
	AA1301-B1	○	○ (VOC規制未対応)	○
柔軟タイプ	AA1101-V	調査中	○	○
	AA1101-S	○	○	○
	FA-750	調査中	○ (VOC規制未対応)	調査中
	AA07	○	○	○

海外インベントリー登録状況②

■ REACH（欧州）につきましては別途ご相談下さい

※REACH（欧州）登録あり。

タイプ	品名	TSCA (米国)	IECSC (中国)	TCSI (台湾)
高接着タイプ	XA-5905	×	○	○
	AA1221-P	○	○	○
狭ピッチ電極対応タイプ	AA2901-A	調査中	○ (VOC規制未対応)	○
錫電極対応タイプ	XA-5617、XA-5651A	×	○	○
短時間硬化タイプ	AA2201-A	調査中	○	○
	AA2141-E※	○	○	○
シタリングタイプ（加圧）	AA1901-EP1	○	○	○
シタリングタイプ（無加圧）	AA1901-EN1	○	○	○
	AA1901-JE1	○	○	○
低銀含有タイプ	AA14	×	○	○
絶縁タイプ	AZ2121-N1	調査中	○	○
	AZ1221-T2	調査中	○	○
	AZ2152-H3	○	○	○



<https://www.fkkasei.co.jp/>

電子材料事業部 営業部

〒105-0011 東京都港区芝公園2-6-15 黒龍芝公園ビル TEL : 03-3436-1100

カタログ改訂履歴

改訂日	改訂内容
2021年5月19日	初版
2022年7月12日	低温硬化タイプAA2121-A、AA2101-A、AA2101-B、AA2001-C 狭ピッチ電極対応タイプXA-5630 樹脂中シンタリングタイプAA1901-H 削除
2022年7月12日	低温硬化タイプAA2121-Mシリーズ、AA2001-D 高耐熱タイプAA1221-R AA1301-B1 高接着タイプAA1229-A、AA1221-P 無加圧型シンタリングタイプAA1901-B、AA1901-J 絶縁タイプAZ2121-N1、AZ1221-T2、AZ2151-H3 追加
2022年7月12日	「樹脂中シンタリングタイプ」⇒「無加圧型シンタリングタイプ」に変更 用途例に「LED素子」、「フレキシブルビーコン」追加 用途例に「セラミックパッケージ部品」追加
2023年4月27日	低温硬化タイプAA2121-D 柔軟タイプXA-9521N 高接着タイプAA1229-A 無加圧シンタリングタイプAA1901-B、AA1901-J 短時間硬化タイプAA2221-A 削除
2023年4月27日	低温硬化タイプAA2001シリーズ 柔軟タイプAA1101-S 無加圧シンタリングタイプAA1901-E1、AA1901-JE1 追加
2023年9月12日	用途例に「パワー半導体」追加 無加圧シンタリングタイプAA1901-E1 削除 シンタリングタイプ（加圧）AA1901-EP1、シンタリング（無加圧）AA1901-EN1 追加